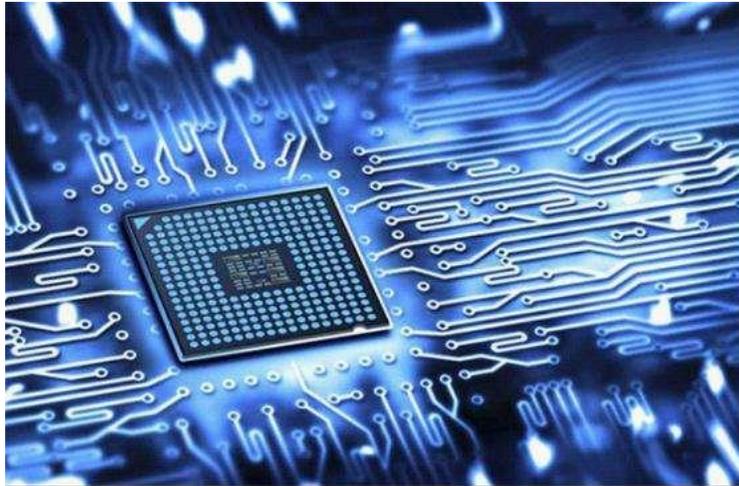


《电镀与精饰》期刊
“先进电子制造电子电镀技术”主题专辑
征文通知及投稿须知



尊敬的各位科研工作者及专业人士：

为了支撑国家高端制造战略安全，推动我国半导体器件及集成电路制造技术发展，促进电子电镀技术在先进电子制造中的应用与创新突破，激发科研人员及专业人士的科研热情，传播最新科研成果，本刊决定举办“先进电子制造电子电镀技术”主题专辑征文，主题方向为“电子电镀技术在半导体器件及集成电路制造中的应用与突破”。现将有关事项通知如下：

一、征文主题：先进电子制造电子电镀技术。

二、征文对象：从事上述相关研究与应用的各界产、学、研学者、专家及工程技术人员等。

三、征文内容：围绕先进电子制造电子电镀技术研究论文、技术应用论文及综述，内容涵盖半导体器件、芯片、印制线路板、封装集成以及新兴电子等先进电子制造中涉及的科学机制、技术及应用，相关技

术的国内外研究现状及发展趋势。突出技术创新和应用创新。

四、征文要求

1. 题目自拟，体裁不限，研究及应用类文章为主，字数控制在5000~6000字以内，综述类文章可以适当放宽字数，但以不超过8000字为宜（不含空格）。

2. 征文内容须具有科学性、创新性和实用性，数据准确，论点清晰，逻辑严谨。

3. 作者需经《电镀与精饰》投稿系统向本刊投稿。投稿请注明“先进电子制造电子电镀技术征文”字样。

4. 投稿截止日期：2024年9月30日。

5. 投稿论文书写格式应符合科技论文写作规范，符合本刊投稿系统中给出的“投稿须知”具体要求，包括投稿论文中的图、表、公式、排版和文献著录格式均需规范。具体要求如下：

a. 文章结构：包括标题、作者、摘要、关键词、引言、正文、结论、致谢、参考文献等部分。

b. 字体和字号：全文采用宋体，字号为五号字，行间距为1.5倍行距。

c. 图表公式：图表应清晰明了，公式应按照数学公式编辑器进行排版。图尺寸不大于：40 mm×60 mm。

d. 文献著录：参考文献应按照科技论文标准格式进行著录，包括作者、文献名、期刊、发表时间、卷期等信息。

五、投稿及录审流程

本次征文作者需经《电镀与精饰》投稿系统向本刊投稿。《电镀与精饰》投稿网址：<http://www.pfoc.org.cn>

投稿后文稿将首先经本刊责编初审，再送主编李明教授主审，如符合要求，将按编辑部编审流程进行处置，经主审合格的投稿论文将编入《电镀与精饰》期刊专辑：先进电子制造电子电镀技术-应用与突破，经编校后出版。论文（电子版）在本期刊网站、微信公众号等平台推送。

希望相关领域的科研工作者及专业人士积极参与，踊跃投稿，共同推动我国半导体集成电路产业的发展。让我们用科技改变未来，用智慧创造辉煌！

《电镀与精饰》编辑部

